

各種電極に対して、安定した耐落下衝撃特性を発揮

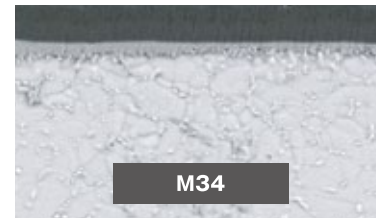
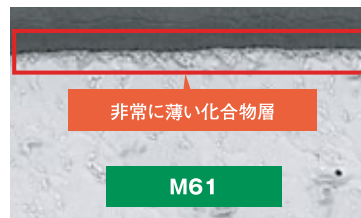
Provides stable drop impact resistance for various types of electrodes

特長

- ソルダボール用途、Sn-Ag-Cu+ α 。
- 各種電極に対して高い耐落下衝撃信頼性を有する。

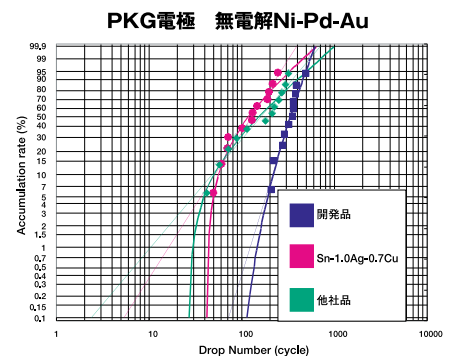
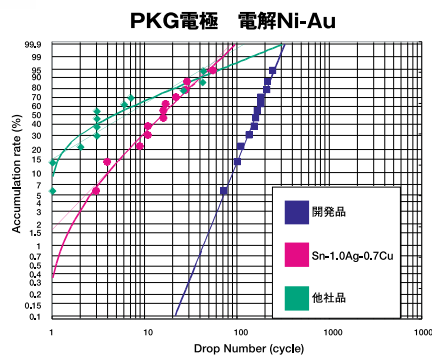
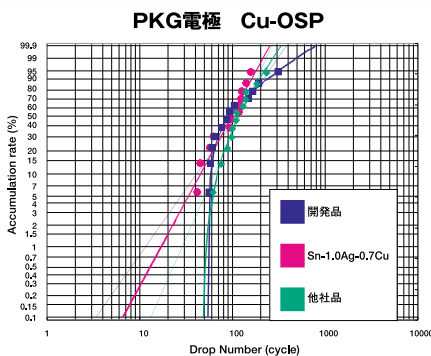
製品仕様

□ 接合界面写真 ■ PKG電極：電解Ni-Au



■ 推奨プロファイル 昇温温度：1~5C/秒 230COver：30~40秒
ピーク温度：240~250C 冷却速度：-5.0deg.C/秒

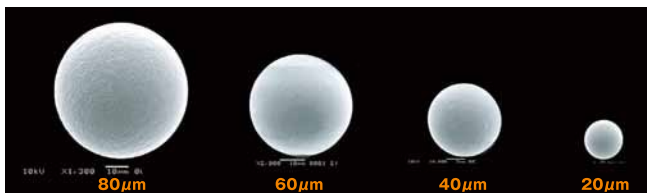
□ 繰り返し落下試験結果 ■ 基板電極：Cu-OSP ■ ソルダボール：0.3mm



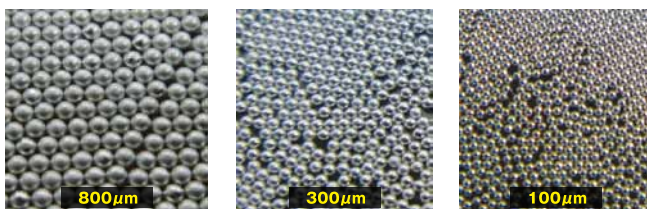
特長

- 各種組成、各種サイズを用意いたしました

□ 小径ボール 100 μ m以下



□ 大径ボール 800~100 μ m



品名	組成	溶融温度(°C)			備考
		固相線	ピーク	液相線	
M61	Sn-Ag-Cu+ α	217	219	260*	*液相線温度は微小な反応落下対策 各種電極対応
M771	Sn-1.0Ag-0.7Cu	217	219	224	
M34	Sn-1.0Ag-0.5Cu	217	219	227	
M52	Sn-1.0Ag-0.1Cu-0.05In-0.02Ni	218	219	228	Cu電極 落下対策
M60	Sn-2.3Ag+ α	221	222	225	耐温度サイクル用
M705	Sn-3.0Ag-0.5Cu	217	219	220	
M30	Sn-3.5Ag	221	223	223	
M200	Sn-0.7Cu	227	228	228	
L20	Sn-58Bi	139	140	140	